

## 財團法人台灣設計研究院 函

地址：110台北市信義區光復南路133號

聯絡人：鍾惠淳

電話：2745-8199#536

電子信箱：sky\_chung@tdri.org.tw

受文者：國立雲林科技大學

發文日期：中華民國113年8月27日

發文字號：台設字第1131002847號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：0920\_低碳包裝與永續設計論壇暨分享會簡章

主旨：本院執行經濟部國際貿易署113年「出口產品減碳包裝標準設計輔導計畫」之低碳包裝與永續設計論壇暨分享會活動，敬請貴校協助轉發活動資訊，請查照。

說明：

- 一、在全球氣候變遷壓力下，低碳包裝已成為企業實現永續發展的重要策略之一。本場論壇將聚焦低碳永續的未來策略與國際趨勢。現場邀請多位業界專家，分享他們在綠色包裝設計方面的實戰經驗與成功案例，探討如何兼顧永續價值與經濟效益。
- 二、9/20【低碳包裝與永續設計論壇暨分享會】，活動資訊：<https://www.tdri.org.tw/48938/>，報名連結：<https://tdri.surveycake.biz/s/9RGwd>，邀請貴校設計學院教職員與學生一同報名參與。
- 三、聯絡窗口：台灣設計研究院，產業前瞻組，鍾小姐。電話：02-2745-8199分機536，E-mail：sky\_chung@tdri.org.tw

正本：華梵大學、大葉大學、長榮大學、東吳大學、亞洲大學、東海大學、銘傳大學、中原大學、元智大學、實踐大學、義守大學、大同大學、逢甲大學、世新大學、靜宜大學、國防大學、國立中正大學、國立宜蘭大學、國立高雄大學、國立臺灣大學、國立清華大學、國立臺北大學、國立臺南大學、國立東華大學



、國立政治大學、國立中興大學、國立中央大學、國立成功大學、國立中山大學、國立臺中教育大學、國立彰化師範大學、國立雲林科技大學、中國科技大學、明志科技大學、僑光科技大學、樹德科技大學、弘光科技大學、嶺東科技大學、景文科技大學、中臺科技大學、崑山科技大學

副本：

113/08/28  
08:02:43